

1N6626 thru 1N6631

ULTRA FAST RECTIFIERS

Features

- AXIAL AND SURFACE MOUNT CONFIGURATIONS
- HIGH VOLTAGE WITH ULTRA FAST RECOVERY TIME
- VERY LOW SWITCHING LOSS AT HIGH TEMPERATURE
- LOW CAPACITANCE
- METALLURGICALLY BONDED
- NON-CAVITY GLASS PACKAGE
- SURFACE MOUNT DIODES THERMALLY MATCHED FOR USE ON CERAMIC PRINTED WIRING BOARDS
- AXIAL AND SURFACE MOUNT AVAILABLE AS JANTX AND JANTXV PER MIL-S-19500/590

Maximum Ratings @ 25°C

TYPE NUMBER	REVERSE VOLTAGE	OPERATING CURRENT (Note 1)	OPERATING CURRENT (Note 3)	PEAK FORWARD SURGE CURRENT (Note 2)	$R_{\theta-JL}$ L = .375"	$R_{\theta-JEC}$
1N6626 and US	200	4.0A	2.0A	75A	22°C/W	10°C/W
1N6627 and US	400	4.0A	2.0A	75A	22°C/W	10°C/W
1N6628 and US	600	4.0A	2.0A	75A	22°C/W	10°C/W
1N6629 and US	800	3.0A	1.4A	75A	22°C/W	10°C/W
1N6630 and US	900	3.0A	1.4A	75A	22°C/W	10°C/W
1N6631 and US	1000	2.5A	1.4A	60A	22°C/W	10°C/W

Operating Temperature: -65°C to +175°C.

Storage Temperature: -65°C to +200°C.

Note 1: TL = +75°C, L = .375 inch for axial parts. Derate linearly at 1.0% / °C for TL > +75°C. For surface mount devices, US suffix, these currents apply with a maximum end cap temperature of 110°C. Derate linearly at 1.5% / °C above 110°C.

Note 2: Test pulse = 8.3ms, half sine wave.

Note 3: Independent of heatsinking.

Electrical Characteristics @ 25°C

TYPE NUMBER	MINIMUM BREAK-DOWN VOLTAGE V_R $I_R = 50\mu A$	MAXIMUM FORWARD VOLTAGE V_F @ I_F	MAXIMUM D.C. REVERSE CURRENT I_R @ RATED REVERSE VOLTAGE $T_A = 25^\circ C$	MAXIMUM REVERSE RECOVERY TIME t_{rr} Note 1	MAXIMUM JUNCTION CAPACITANCE C_j $V_R = 10V$	PEAK RECOVERY CURRENT $I_{RM} (mA)$ $I_F = 2A$, 100A/μs	FORWARD RECOVERY VOLTAGE $V_{FRM} (Max.)$ $I_F = 0.5A$ $t_r = 12ns$
	V	V @ A	V @ A	μA	ns	pf	A
1N6626 and US	220	1.35V @ 1.2A	1.50V @ 4.0A	2.0	500	30	40
1N6627 and US	440	1.35V @ 1.2A	1.50V @ 4.0A	2.0	500	30	40
1N6628 and US	660	1.35V @ 1.2A	1.50V @ 4.0A	2.0	500	30	40
1N6629 and US	880	1.40V @ 1.0A	1.70V @ 3.0A	2.0	500	50	40
1N6630 and US	990	1.40V @ 1.0A	1.70V @ 3.0A	2.0	500	50	40
1N6631 and US	1100	1.60V @ 1.0A	1.95V @ 2.5A	4.0	600	60	40

NOTE 1: Reverse Recovery Time Test Conditions: $I_F = 0.5A$, $I_{RM} = 1.0A$, $I_R(REC) = 0.25A$.

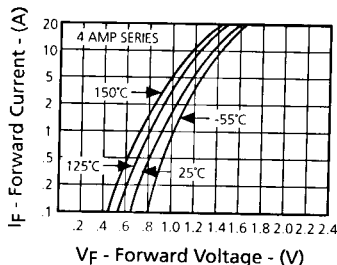


FIGURE 2
Typical Forward Current
vs
Forward Voltage

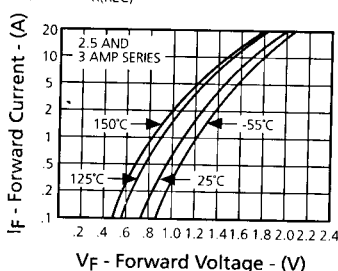


FIGURE 3
Typical Forward Current
vs
Forward Voltage

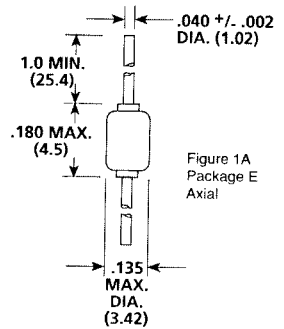
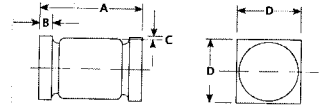


Figure 1A
Package E
Axial

1N6626US thru 1N6631US



	Inch	MIN.	MAX.	mm	MIN.	MAX.
A	.205	.225		5.080	5.350	
B	.019	.028		0.483	0.711	
C	.003			0.076		
D	.137	.142		3.480	3.759	

Figure 1B
Package E
Surface
Mount

Mechanical Characteristics

AXIAL LEADED DEVICES

CASE: Voidless Hermetically Sealed Hard Glass.

LEAD MATERIAL: Solder Dipped Copper.

MARKING: Body Painted, Alpha Numeric.

POLARITY: Cathode Band.

SURFACE MOUNT DEVICES

CASE: Voidless Hermetically Sealed Hard Glass.

END CAP MATERIAL: Solid Silver.

END CAP CONFIGURATION: Square.

POLARITY: Cathode Dot on End Cap.

1N6626 thru 1N6631 AXIAL LEADED
1N6626US thru 1N6631US SURFACE MOUNT

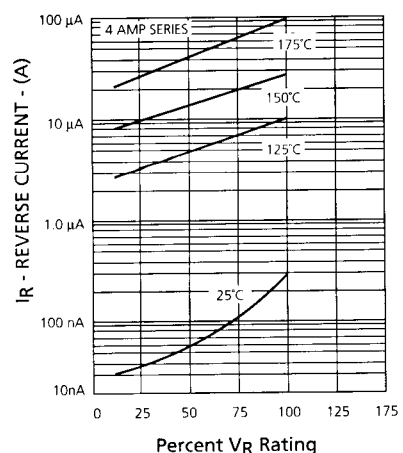


FIGURE 4
Typical Reverse Current vs
Applied Reverse Voltage

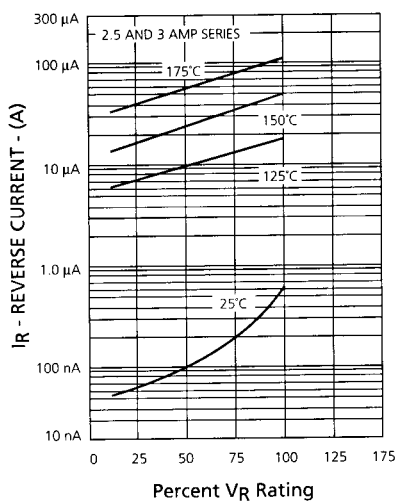


FIGURE 5
Typical Reverse Current vs
Applied Reverse Voltage

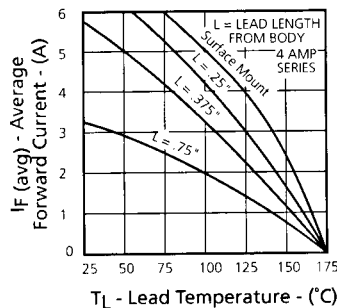


FIGURE 6
Average Forward Current vs
Lead Temperature (50% Duty Cycle, Square Wave)

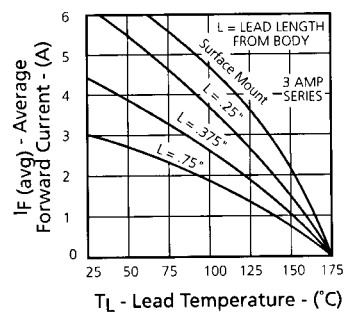


FIGURE 7
Average Forward Current vs
Lead Temperature (50% Duty Cycle, Square Wave)

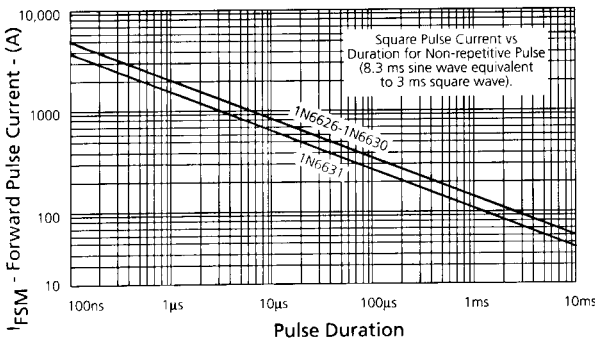


FIGURE 8
Forward Pulse Current vs
Pulse Duration

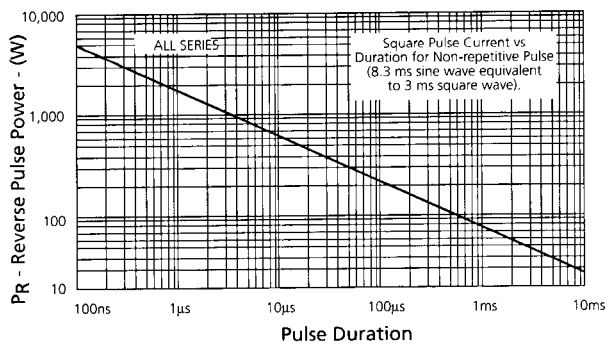


FIGURE 9
Reverse Pulse Power vs
Pulse Duration

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9